

长鑫科技十年复盘

拥抱“追赶者的最好时代”

7月27日,长鑫科技成功登陆上交所科创板,市值居A股上市公司第一位。

十年栉风沐雨,十年锐意攻坚。十年来长鑫科技扎根合肥、实现中国存储芯片产业国产化重大突破的不凡历程,是我省全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,坚持科技打头阵,锚定“三地一区”实现新突破和取得“三个新的更大进展”目标的标志性成果,必将被载入安徽发展的史册。

从5月27日成功过会,到如今上市交易,两个月来,长鑫科技的每一个动向都处于国内外资本市场、半导体乃至人工智能行业的关注之下。

从截至去年底累计亏损366.5亿元,到今年一季度实现归母净利润247.62亿元,有人说,长鑫科技只是因为站在了“风口”——全球存储芯片行业历史性的超级景气周期。

这当然是最直接的归因。但是,风口来了,为什么接住的是长鑫科技?

十年前的2016年,长鑫科技在安徽合肥起步。

彼时,中国作为全球最大的电子产品制造基地,每年需要大量的存储芯片,却还没有一条真正意义上的自主DRAM(动态随机存取存储器,通常被称为内存芯片)生产线——国内虽已具备芯片设计能力,但大规模商业化量产仍是空白。

长鑫科技选了一条看上去很“冒险”的路:它没有从落后几代的工艺节点开始慢慢追赶,而是“跳代研发”,用跨代追赶替代线性追赶。如今,其产品矩阵已经覆盖DDR5、LPDDR5、LPDDR5X全系列。

与市场景气同时发生的另一件事也很关键:长鑫科技产能规模化的拐点到了。

合肥、北京共3座12英寸晶圆厂持续扩产,刚好卡在通用DRAM结构性短缺的时间窗口。从曾经的“不被统计”到全球7.67%的市占率、稳居第四——产能扩张与市场需求在同一个时点交汇,盈利便由此爆发。

产业链也在同步跟进。据行业机构测算,长鑫科技的设备国产化率持续攀升,原材料采购突破百亿元,封测配套同步跟进。一家产能拉满、持续扩产的存储

龙头,正把订单的确定性源源不断传递给上下游。

当此长鑫科技顺利登陆科创板的“高光时刻”,更需要对这10年长鑫科技与合肥共同走过的道路进行一次理性复盘,在尝试解答“长鑫为什么”的过程中,梳理出一些应然和必然的底层逻辑。

每一家企业的成长之路都难以复制,但总有一些“密码”有助于打开通向未来之门。

“长期主义”

从“战略性亏损”到盈利,长鑫科技表面上得益于产品价格,根子上赢在战略定力。

“怀揣补齐短板、保障供应链安全的初心,我们选择走上一条重投入、长周期、高难度的自主研发之路。”在7月15日的长鑫科技IPO路演中,长鑫科技董事长朱一明说。

这条路的核心策略,便是“跳代研发”。

长鑫科技2016年成立,2019年推出自主设计生产的8Gb DDR4产品,实现中国大陆DRAM产业“从零到一”的历史性突破;随后短短数年间,快速完成从第一代到第四代工艺技术平台的量产,同步实现DDR5等高端产品的覆盖和迭代,核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。

跳代研发的底气,来自高强度的研发投入与完善的知识产权体系。截至2025年末,长鑫科技合计拥有境内外专利6972项,国际专利排名国内企业前列。这些专利覆盖了产品设计、制造工艺、封装测试、模组应用全链条,构建起一道坚实的技术护城河。

放眼全球,专注DRAM设计的公司不少,但能真正实现大规模量产的,少之又少。长鑫科技从一开始就选择了IDM(垂直整合制造)模式,即将研发、设计、制造等环节握在手中。

这是一条“烧钱”的路。新建DRAM晶圆制造产线所需资本支出极高,但IDM模式意味着更短的研发周期、更高效的内部协同,以及对客户需求更快的响应。

如今,长鑫科技已在合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂,产能

规模位居中国第一、全球第四,在2025年第四季度,其全球市场份额已达到7.67%。虽然距离前三强仍有差距,但这意味着长鑫科技已稳稳地坐在了牌桌上,拥有了参与全球竞争的入场券。

技术再强,没有生态便是孤岛。长鑫科技的另一大竞争力,在于编织了一张紧密的本土产业链网络。

客户名单最能说明问题。阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo……众多国内头部科技企业都已成为长鑫科技的深度合作伙伴。这些名字的背后,是中国最庞大的电子制造和互联网生态。

长鑫科技的业绩爆发,本质上是产品力得到了主流客户的全面认可。尤其是随着AI算力需求爆发,国内云厂商加速供应链多元化布局。在全球供应链充满不确定性的时代,长鑫科技凭借稳定的交付能力与不断提升的产品性能,成为市场客户重要的自主可控战略选择,这也是其2025年以来业绩高速增长的核心驱动力之一。

DRAM行业是典型的人才密集型行业,长鑫科技组建了一支全球化的资深技术团队,核心管理层普遍拥有25年以上半导体从业经验,研发人员占员工比例超过30%。

在公司治理上,长鑫科技计划上市后通过股权激励、长锁定期等安排绑定核心技术团队,引导员工着眼长期技术突破,避免短期逐利思维。

秉持“长期主义”,是长鑫科技能够穿越周期、坚持技术投入的底层原因。

追赶者的“最好时代”

长鑫科技的业绩爆发,根基在于自身实力,“引爆点”则是踩中了行业周期向上的节点。

海量数据的实时读写与高效处理,离不开DRAM芯片的核心支撑。

DRAM对数据处理的速度与效率具有重要影响,是满足数字经济时代高吞吐、低延迟数据需求的基础硬件。

过去几十年,DRAM需求主要由消费电子和传统PC驱动,增长相对平稳且

周期性明显。

AI浪潮的到来,彻底改变了需求的量级与结构。

“全球数据总量呈现爆发式增长。”长鑫科技招股书中这句陈述,揭示了庞大的市场需求。

2025年,全球DRAM下游应用领域中,服务器市场需求占比约50%。而到2030年,这一比例将增长至71%。这种量级的跃升,直接将DRAM市场的成长天花板大幅抬高。

当需求端出现AI这样的史诗级变量,且其增长斜率远超过去以PC和手机驱动的时代时,行业的成长属性开始超越周期属性。

据预测,全球DRAM市场规模将从2025年的1505亿美元,一路攀升至2030年的5710亿美元,年均复合增速超30%。

我国DRAM消费需求规模占全球比重超过四分之一。近年来,长鑫科技已逐步进入全球主要DRAM厂商阵营,并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。

产品迭代是存储产业的永恒主题。

随着场景数字化的持续渗透推动全球数据量规模化扩张,市场对更高性能的DRAM产品有着越来越强烈的需求,各大厂商持续探索DRAM的新型架构及制造封装工艺。

对于长鑫科技而言,紧跟代际演进节奏,保持产品竞争力,是未来持续扩大市场份额的关键。

更重要的是,随着摩尔定律放缓,国际领先DRAM企业已进入制程节点微缩瓶颈,新产品开发中面临的成本巨幅增长与物理极限的逼近问题导致工艺难度大幅提升。

对于追赶者而言,这是最好的时代。当领跑者也需要在新技术路线上摸索时,后来者与他们在某些领域站到了同一起跑线上。

正如长鑫科技招股书所说,“国内厂商与国际前三家厂商均处于探索阶段,国内厂商有望抓住产业革新机会迎来快速发展机遇,甚至实现部分弯道超车。”

对于长鑫科技而言,真正重要的不在于周期高点赚多少钱,而在于能否利用行业景气期快速扩大规模、提升技术、完善生态,在下一轮周期波动中具备更强的抗风险能力。

从这个角度看,此次IPO上市不仅是融资,更是为穿越下一个周期“储备弹药”。

与其说长鑫科技“撞上”了风口,不如说它眼里其实没有风口,而只是站在行业规律的“应然”一边。

朱一明在路演中称,“长鑫科技会积极把握AI算力带来的存储增量机遇,但也会客观看待DRAM行业的强周期性特征,通过多元化下游布局分散周期波动风险。”

“链主”的三重价值

长鑫科技本次IPO募投项目计划投资额为295亿元。这笔钱投下去,一条涵盖设备、材料、封测、模组的完整产业链或将重新定义。

其招股书显示,本次募资三大投向:75亿元用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造,130亿元用于DRAM存储器技术升级,90亿元用于前瞻技术与开发。通俗来说,钱用在研发和扩产上。

扩产就意味着买设备。

长鑫科技已成为国产设备最重要的验证和应用平台。长鑫科技2026年二季度已启动设备招投标,全年计划扩产5万片至6万片,设备采购规模达50亿美元至60亿美元,此次招投标“优先采购国产设备”。
(下转四版)

长鑫科技在科创板上市

7月27日,拍摄的位于合肥空港工业园的长鑫科技集团股份有限公司。当日,长鑫科技正式登陆上交所科创板。
葛传红 摄

